

RFID印刷型银浆介绍

一、主要性能和特点:

- 1、 由于专门针对印刷产品定制，产品工艺裕度大，能满足客户的各种使用条件，并且不需特别工艺调整；
- 3、 根据客户需要有：激光雕刻银浆（20~50um）、精细型印刷银浆（50um~100um）和普通型印刷银浆（≥100um），有低温快干型和普通型，有低卤和无卤等各种类型供客户选择；
- 4、具有优良和广泛的附着力特性，几乎完全兼容目前的所使用的各种PET薄膜、ITO薄膜以及玻璃基板、纸张等材质，并能根据客户的特定基材进行专门开发；
- 5、有优良的导电性能和抗氧化性，同时可以根据客户的需要进行导电性能以及导电金属（银、银铜、镍、镍铜、铝、银铝等等）的调节，从而降低客户不必要的成本；
- 6、借助于独特的树脂和溶剂体系，固化后的浆料不会和绝缘油墨发生反应而降低性能；

二、主要参数:

（以下性能及测试来源于我们的实验室，不能保证绝对的正确。我们可以根据客户的需要进行性能的调整和改进以适应客户的各种需要）

	激光雕刻型	精细印刷型	普通印刷型	备注
用途（线宽）	20~50um	50~100um	≥100um	印刷线宽和线距
外观	灰色浆状	灰色浆状	灰白色浆状	目测
粘度（kcps）	15~30	150~170	15~30	BROOKFIELD HBDV- II (S14, 50r, 25℃)
干燥条件	电热烘箱，130℃×20分钟（普通）； 130℃×10分钟（快干） 90~100℃×30分钟（快干）			
银浆典型方阻 (mΩ/□)	≤20	≤30	≤15	膜厚25.4um(阻值可根据客户需求调整)
附着力	无脱落			交叉十字裂口剥落 测试，3M600胶带， 垂直剥离
硬度	≥3H	≥2H		铅笔硬度计
抗挠曲度(ΔR/%)	≤500	≤300		5Kg 5次，1min

三、使用和操作注意事项:

- 1、请按浆料使用前的推荐条件进行使用，稀释请使用专用的溶剂；
- * 请在使用之前和混入溶剂之后进行充分的搅拌。
- 2、请保持适当的印刷间距，并根据网版目数和工艺条件选择适宜的浆料**
- ** 设置最佳印刷条件，保证印刷厚度在6~15 μm之间；
- 3、用完后对网版和器具的清理请使用酮系和酯类清洗剂；
- 4、操作应用时请穿戴好防护服并在良好的通风环境系统中进行；
- 5、浆料在5~10℃ 可以存放6个月；
- 6、银浆从冷藏状态取出时，不要急于打开使用，待银浆温度恢复到室温时再开盖使用，以防空气中水份进入而影响银浆质量。